

# 半導体関連部品

## Ceramic Packages

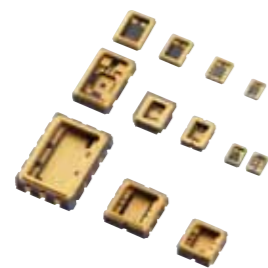
### セラミックパッケージ・基板

豊富な材料技術、多彩な加工技術、機能を引き出す設計技術を核に、スマートフォンなどに使われる小型部品、光通信部品、車載ヘッドライト用LEDなど、幅広い製品に向け、高い信頼性を持つセラミックパッケージ・基板を提供しています。



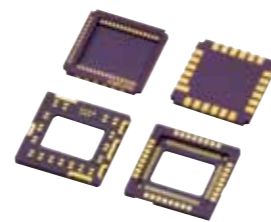
#### 電子部品用表面実装セラミックパッケージ

水晶振動子などに向けた超小型の表面実装セラミックパッケージ。スマートデバイスの小型化、高性能化を支えています。



#### イメージセンサ用セラミックパッケージ

高性能化・薄型化が進化するカメラモジュールを、イメージセンサ用セラミックパッケージが支えています。



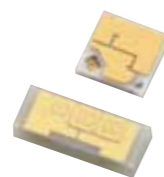
#### 光通信部品

光通信デバイスを保護し、高速伝送を実現する光パッケージや光ファイバー接続用部品などを通じて、情報化社会を支えています。



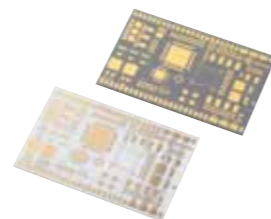
#### LED用セラミックパッケージ

一般照明、車載ヘッドライトなど用途が広がるLEDに、熱伝導率や信頼性の高いセラミックパッケージが採用されています。



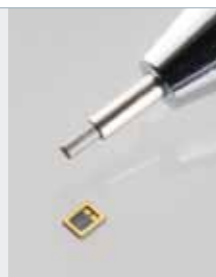
#### 車載ECU用セラミック多層基板

小型、高密度、高耐熱、高熱放散性を備えたECU基板。高い信頼性で、車載用に採用されています。



#### 水晶デバイスの小型化に貢献

超小型セラミックパッケージが、電子機器に欠かせない高性能な水晶デバイスの小型化に貢献。写真の製品は1.2mm×1.0mmというサイズの中で、気密性と高い信頼性を実現しています。



#### 高演色LED照明「CERAPHIC®」

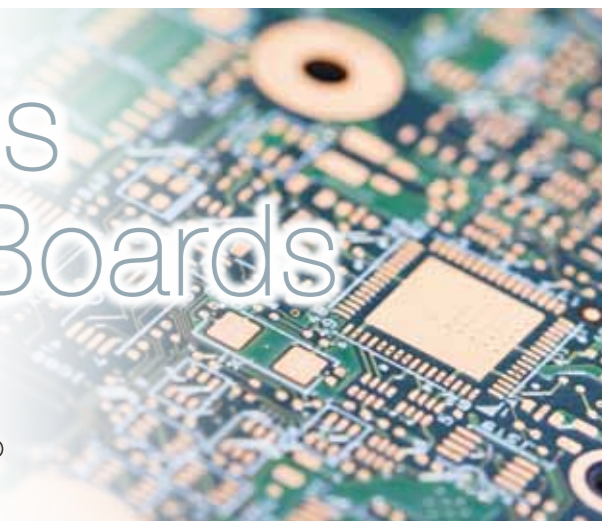
光の表現にこだわったカスタムLED照明は、美術館や博物館、色彩検査や植物育成にも採用され、人々の暮らしや社会をより豊かにしています。



# Organic Packages & Printed Wiring Boards

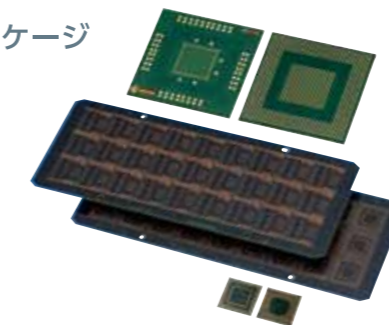
## 有機パッケージ・プリント配線板

情報通信技術の急速な発展とインターネットの普及により、飛躍的に進む電子機器の高性能化・多機能化を有機多層パッケージやプリント配線板を通じて支えています。



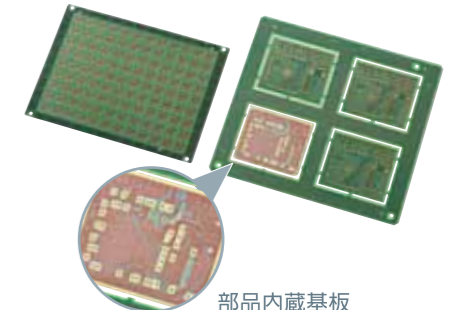
#### フリップチップパッケージ

最先端の微細配線や薄型多層技術を駆使し、高精細な多層パッケージを実現。サーバー、ルーター、携帯通信端末の進化に貢献します。



#### モジュール基板

スマートフォンや車載向けの通信モジュールに使われる有機基板。コンデンサなどの部品を内蔵した部品内蔵基板も注目されています。



部品内蔵基板

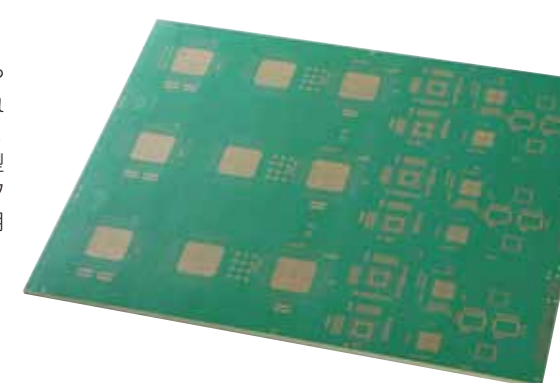
#### ビルドアップ配線板

パソコンや携帯端末などの高密度な表面実装が求められる製品に広く採用されています。



#### 高多層基板

ハイエンドサーバーや通信システムに使われる高性能な配線板。50層にもなる大型マザーボードやバックプレーンボードに採用されています。



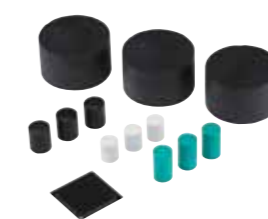
# Organic Materials

## 有機化学材料

有機化学をベースに、デジタル機器、自動車、エネルギー、環境保全など幅広い産業分野に事業領域を拡大しています。

## 半導体用エポキシ封止材料

従来のトランスファ成形に加えて、圧縮成形に対応する新材料も取り揃え、各分野で活躍しています。



## ダイアタッチペースト

半導体/LED/電子部品のダイアタッチペーストをラインアップ。高熱伝導タイプ、低温硬化可能タイプなどニーズに合わせた材料を提供しています。

